

■ 半導体・IC (市場、アプリケーション、部品、その他)

調査レポートの詳細はデータリソースホームページで、 www.dri.co.jp/bunya/semi.htm

◆ [802.15.4とZigbee: チップセットとアプリケーション](#)

◆ [DVIとHDMI調査 2011年: 市場動向、技術、製品タイプ毎の2015年までの予測](#)

■ 出版社 インスタット社 ■ 出版日 2011年11月 ■ 価格 US\$ 3,495-3,995

◆ [イーサネットスイッチとPHYチップのガイド 第8版](#)

■ 出版社 リンレイグループ社 ■ 出版日 2011年11月 ■ 価格 US\$ 3,495

◆ [中国のインゴットメーカーとウエハーメーカー \(第4版\)](#)

■ 出版社 ENF社 ■ 出版日 2011年11月 ■ 価格 2,600ユーロ

◆ [ロシアとロシア周辺国 \(CIS・バルト3国\)のRFID市場調査](#)

■ 出版社 IDTechEx社 ■ 出版日 2011年11月 ■ 価格 US\$ 3,495

◆ [短距離無線の半導体とデバイス: 携帯電話、家電デバイス、セキュアエレメント、ブリッジソリューション、タグ、](#)

◆ [RFパワーアンプ: セルラーとモバイル無線インフラ市場の機器とRFパワーデバイス](#)

◆ [4Gスマートフォン: WiMAX、LTE、4Gの半導体、スペクトラム、市場](#)

■ 出版社 ABIリサーチ **注目** ■ 出版日 2011年10月 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)

◆ [世界のNFCチップとタグ市場の分析と予測](#)

◆ [DisplayPort調査: 主要3規格\(外部/組み込み/内部\)とモバイル市場の動向と予測](#)

◆ [2011年第4四半期 USB市場予測: 機器タイプ/技術毎の2015年までの予測](#)

◆ [2011年第4四半期 PC/ディスプレイインターフェース市場予測: 機器タイプ/技術毎の2015年までの予測](#)

■ 出版社 インスタット社 ■ 出版日 2011年10月 ■ 価格 US\$ 2,995-6,995

◆ [通信向け半導体市場予測 2010-2015年](#)

◆ [モバイル向け半導体の市場シェア予測 2010-2015年](#)

■ 出版社 リンレイグループ社 ■ 出版日 2011年10月 ■ 価格 US\$ 3,495

◆ [LTEベースバンド、RF、アプリケーションプロセッサの競争分析](#)

■ 出版社 ヘビーリーディング社 ■ 出版日 2011年10月 ■ 価格 US\$ 3995

◆ [世界のウエハー生産能力分析と予測 2011-12年](#)

■ 出版社 ICインサイツ社 ■ 出版日 2011年10月 ■ 価格 US\$ 4,190

◆ [Wi-Fiチップセットの変革: シングル、デュアル、トライバンド、MIMOコンフィギュレーション](#)

◆ [MEMSベンダの競争分析: センサ、ディスプレイ、オーディオ、RF、タイミングデバイス](#)

◆ [世界の太陽光発電のセルとモジュールの市場: 多/単結晶シリコン、ハイブリッド単結晶シリコン、非結晶半導体、](#)

◆ [中国と台湾の携帯端末用半導体サプライヤ: 主要9社の競争分析、製品ポートフォリオ、企業概要](#)

■ 出版社 ABIリサーチ **注目** ■ 出版日 2011年9月 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)

◆ [半導体自動検査装置\(ATE\)市場\(世界\)](#)

■ 出版社 フロスト&サリバンス社 ■ 出版日 2011年9月 ■ 価格 US\$ 6,000

◆ [世界の半導体市場調査 2011年](#)

■ 出版社 RNCOS社 ■ 出版日 2011年9月 ■ 価格 US\$ 1,700

◆ [プリントドRFIDとチップレスRFID市場調査](#)

■ 出版社 IDTechEx社 ■ 出版日 2011年9月 ■ 価格 US\$ 3,495

-
- ◆ [自動車用のMEMSセンサ:アクセラレータ、ジャイロスコープ、エアバッグの圧力センサ、ESP、TPMシステム](#)
 - ◆ [高出力RF半導体:セルラーと無線インフラネットワーク機器](#)
 - ◆ [SoC\(システムオンチップ\)半導体のセットトップボックスビデオ:CATV、衛星TV、IPTV、地上波のIC](#)
- 出版社 ABIリサーチ [注目](#) ■ 出版日 2011年8月 ■ 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)
-

- ◆ [Bluetooth市場調査 2011年:規格、競合技術、アプリケーションタイプ毎の採用予測](#)
 - ◆ [シリコンチューナー搭載製品\(テレビ/モバイル機器/家電\)市場調査](#)
- 出版社 インスタット社 ■ 出版日 2011年8月 ■ 価格 US\$ 3,495-5,995/11.12.12
-

- ◆ [SMT・チップ部品装着装置市場\(世界\)](#)
- 出版社 フロスト&サリバン社 ■ 出版日 2011年8月 ■ 価格 US\$ 6,000
-

- ◆ [無機および合成材料によるプリントエレクトロニクス市場調査](#)
 - ◆ [フレキシブルエレクトロニクス向けバリアフィルム市場](#)
 - ◆ [RFID市場調査:2021年までの予測、関連企業、将来性](#)
 - ◆ [電子パッケージング市場調査 2012-2022年](#)
- 出版社 IDTechEx社 ■ 出版日 2011年8月 ■ 価格 US\$ 3,495-3,995
-

- ◆ [半導体産業向けセラミック材料OEM市場調査 2011年版](#)
 - ◆ [半導体とLEDアプリケーション向けシリコン製組立部品市場調査](#)
- 出版社 テクセット社 ■ 出版日 2011年8月 ■ 価格 US\$ 2890
-

- ◆ [放送アプリケーション向けRFパワー半導体:FM、HDR/DAB、VHFアナログTV、UHFアナログTV、DTVトランスミッタ](#)
- 出版社 ABIリサーチ [注目](#) ■ 出版日 2011年7月 ■ 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)
-

- ◆ [携帯電話のコアチップのトレンド:チップタイプ\(ベースバンド/アプリケーションプロセッサ/RF/電源管理\)毎の市場分析](#)
- 出版社 フォワードコンセプト社 ■ 出版日 2011年7月 ■ 価格 US\$ 3,850
-

- ◆ [台湾のIC設計業界に与えるiPadの影響](#)
- 出版社 MIC ■ 出版日 2011年7月 ■ 価格 US\$ 1,280
-

- ◆ [GPSの半導体:GPS、Glonass、コンボチップ、内蔵、その他の位置技術](#)
- 出版社 ABIリサーチ [注目](#) ■ 出版日 2011年6月 ■ 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)
-

- ◆ [通信機器向け半導体市場におけるベンダシェアデータ](#)
- 出版社 リンレイグループ社 ■ 出版日 2011年6月 ■ 価格 US\$ 3,495
-

- ◆ [世界の携帯電話と端末用チップの市場調査 2011年](#)
- 出版社 フォワードコンセプト社 ■ 出版日 2011年6月 ■ 価格 US\$ 3,850
-

- ◆ [SiC半導体市場調査 2011年版](#)
 - ◆ [半導体製造プロセス向け湿式化学\(ウェットケミカル\)市場調査](#)
- 出版社 テクセット社 ■ 出版日 2011年6月 ■ 価格 US\$ 2890-3290
-

- ◆ [モバイルプロセッサガイド 第3版](#)
- 出版社 リンレイグループ社 ■ 出版日 2011年5月 ■ 価格 US\$ 3,495
-

- ◆ [世界のマザーボード予測 2011-2015年](#)
- 出版社 MIC ■ 出版日 2011年5月 ■ 価格 US\$ 2,220
-

- ◆ [デジタルスチールカメラと関連セグメント\(機器/機能/レンズ/センサ/半導体\)調査](#)
- 出版社 インスタット社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 3,995
-

◆ [世界のDC-DCコンバータIC予測 \(第11版\):アプリケーション、電流値、新規アプリケーション](#)

■ 出版社 ダーネルグループ社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 3,100

◆ [高度なソリッドステートメモリシステムと製品の市場調査](#)

■ 出版社 イノベティブR&P社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 3,650

◆ [グリーン半導体技術の最新動向と新ビジネス:太陽電池/LEDテレビから電気自動車までの新戦略を解明](#)

■ 出版社 インターネットM総研 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 89,250円/税込

◆ [OSD市場調査 2011年:オプトエレクトロニクス、センサ、ディスクリット半導体市場分析・予測](#)

■ 出版社 ICインサイツ社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 2,890

◆ [半導体用材料ガス類に関する市場調査](#)

◆ [化学機械研磨\(CMP\)消耗品に関する市場調査](#)

◆ [フォトレジストおよび付属薬品に関する市場調査](#)

■ 出版社 テクセット社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 3,890-4,890

◆ [ネットワークプロセッサガイド 第12版](#)

■ 出版社 リンレイグループ社 ■ 出版日 2011年4月 ■ 価格 US\$ 3,495

◆ [スマートフォンと家電のMEMS:アクセラレータ、ジャイロスコプ、磁カメータ、高度計、スクリーン、プロジェクタ、、、](#)

■ 出版社 ABIリサーチ **注目** ■ 出版日 2011年3月 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)

◆ [世界の端末向け構成部品市場の動向と2015年までの予測:チップの出荷台数と収益、比較、メーカーリスト](#)

■ 出版社 インスタット社 ■ 出版日 2011年3月 ■ 価格 US\$ 3,495

◆ [2011年版 自動車エレクトロニクスの現状と将来分析](#)

■ 出版社 総合技研株式会社 ■ 出版日 2011年3月 ■ 価格 92,400円/税込

◆ [半導体製造用スパッタリングターゲット材市場調査](#)

■ 出版社 テクセット社 ■ 出版日 2011年3月 ■ 価格 US\$ 3,890

◆ [世界の高輝度LED\(HB-LEDs\)ドライバICの市場概説と2017年までの予測](#)

■ 出版社 エレクトロニキヤスト社 ■ 出版 2011年3月 ■ 価格 US\$ 4,200

◆ [RFパワー半導体:シリコン、ガリウムナイトライド、ガリウムヒ素、シリコンカーバイド高出力RFデバイス](#)

■ 出版社 ABIリサーチ **注目** ■ 出版日 2011年2月 価格はお問合せ下さい(info@dri.co.jp)

◆ [ZigBeeチップメーカーのアプリケーション開発動向と戦略](#)

■ 出版社 MIC ■ 出版日 2011年2月 ■ 価格 US\$ 1,250

調査レポートの詳細はデータリソースホームページで、

www.dri.co.jp/bunya/semi.htm

無料メールマガジンを提供しています。

データリソースは無料のメールマガジンを発行し、海外市場調査会社の発信する最新情報などを提供しています。配信をご希望の方は、データリソース(Eメール: info@dri.co.jp)までお申し込みください。

株式会社 データリソース

www.dri.co.jp

東京都港区赤坂1-14-5-N313 (〒107-0052)

電話 03-3582-2531 Eメール info@dri.co.jp